

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2026年6月3日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	柏治资本、比邻投资、北大方正人寿资管、东北证券、国华兴益、国联民生证券、华鑫自营、交银基金、金仕达投资、玖石投资、民生基金、瀑布资管、清曜资本、神农投资、六妙星私募基金、鑫元基金、银信投资、运舟资本、中信证券
活动时间	2026年5月26日、5月28日、5月29日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：唐超宇、杨丽颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q1：目前公司存储芯片涨价情况如何？下游接受度如何？</b></p> <p>自2025年下半年以来，存储产品市场价格整体处于上涨通道，主要受大容量产品结构性供需失衡影响，中小容量SLC NAND、DRAM等产品价格稳步上行。分产品看：SLC NAND方面，由于美光、三星、SK海力士等海外大厂陆续退出消费类市场，加之铠侠亦发布特定封装及成熟制程产品的停产通知，市场对中小容量NAND供给趋紧的预期进一步强化；NOR产品则受益于下游容量迭代需求增长及上游晶圆代工成本上升的双重驱动，价格延续上涨趋势；DRAM方面，DDR4因国际大厂策略调整导致供给收缩，而DDR3及LPDDR3受部分客户从DDR4切换回DDR3的需求拉动，价格亦同步上涨。当前下游客户对价格调整的整体接受度较为平稳。本轮存储芯片价格回升的背景是供需结构的实质性改善，需求端呈现AI算力高速增长与传统消费电子稳步复苏的双重驱动特征，客户对供应链稳定性和产品可靠性的重视程度也在持续提升。</p> <p><b>Q2：晶圆厂涨价情况如何？对毛利率的影响几何？</b></p> <p>今年以来，晶圆代工产能持续紧张背景下，代工价格整体呈现上涨趋</p>

势。另一方面，公司面对的存储芯片市场供需结构持续改善，产品价格随行业周期修复而逐步提升。同时，随着存储终端市场对更大容量需求的增长，以及公司先进制程产品占比稳步提升，加之公司与上游晶圆厂保持稳定的合作关系，多方因素共同支撑了公司存储业务盈利能力的稳步回升。具体经营数据请以公司定期报告为准。

**Q3：当前利基型存储芯片供需失衡，公司产能情况如何？是否有新增产能？**

公司作为 Fabless 设计企业，采取“本土深度、全球广度”的供应链策略，与多家国内外知名晶圆代工厂及封测厂建立了长期稳定的战略合作关系。2026 年，公司正有序加大主要产品线的生产与备货力度，以匹配客户订单增长需求。公司对下半年的产能供应情况持积极预期，具体生产规模将根据下游实际需求进行动态调整。

**Q4：砺算 7G100 显卡已然售卖，性能略低于市场预期，请问原因？后续对于砺算公司有何战略安排？**

砺算科技 GPU 产品基于自研架构，定位于图形渲染与通用计算，产品可应用于个人电脑、专业设计、AI PC、云游戏、云渲染、数字孪生等应用场景，其具体产品规格及性能请以砺算科技官方信息为准。公司以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术布局，对砺算的战略投资是上述布局的重要举措，双方将持续深化协同，共同拓展业务发展空间。如涉及重大事项，公司将依据信息披露相关规定及时公告。敬请注意投资风险。

**Q5：砺算 GPU 下游的客户结构公司作何展望？是否会布局 GPGPU？**

砺算科技拥有全栈自研的核心技术体系，目前已面向消费级市场和专业级市场分别推出相应产品，两个市场各有特点和优势。面向消费类市场的产品具备先发优势，是国内中高端图形渲染赛道中较早落地的本土自研方案之一，支持各类主流 API 和图形引擎，在兼容性方面具有独特优势；面向专业级市场，能够兼容部分主流 CAD/3D 建模软件及国内外 CPU/操作系统，适用于数字孪生、摇杆建模与实景渲染、云桌面等应用场景，同样具备差异化竞争力。砺算科技将基于市场需求及自身优势，积极进行产品研发及市场开拓。

**Q6：公司最近公告了发行 H 股的计划，请问港股募资的用途主要是做什么？**

公司于 2026 年 5 月 22 日召开董事会，审议通过了发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案，拟发行不超过发行后公司总股本 10% 的 H 股（超额配售权行使前），并授予不超过前述发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。H 股发行所募集的资金，将主要用于加强核心技术研发、扩充产能及产品矩阵、完善海外布局、战略性投资及收购、补充营运资金等方面。该事项尚需提交公司股东会审议，后续进展公司将及时履行信息披露义务，敬请注意投资风险。

	<p><b>Q7：公司的 WiFi-7 芯片目前进展如何？何时能在报表端看见营收？</b></p> <p>公司在 2024 年设立子公司，专注于 Wi-Fi 7 芯片的研发，研发团队成员拥有国际或国内一线通信芯片大厂的研发经验。目前 Wi-Fi 7 无线通信芯片研发及产业化进展顺利，公司已于 2025 年完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。公司正积极推进相关产品的研发工作，未来随着产品逐步完成客户导入并实现量产，有望为公司带来新的收入增长曲线。具体的营收确认时间取决于客户导入进度和量产节奏，建议投资者关注公司后续公告。</p>
日期	2026年6月3日